

【Phrozen樹脂 使用者指南】

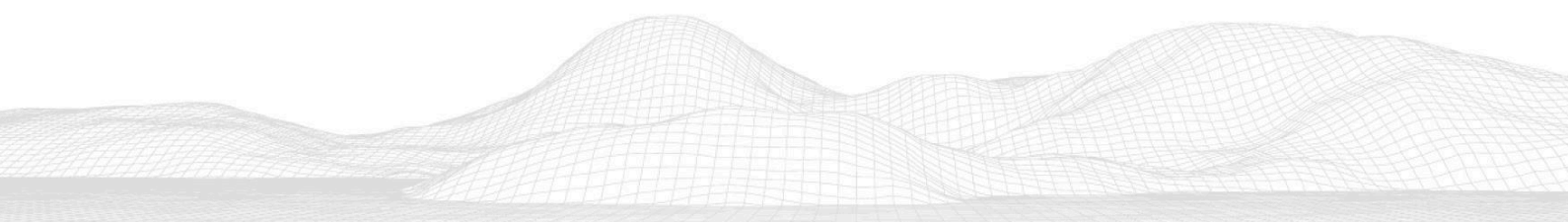
工程韌性樹脂：類ABS+,灰色

大綱

在列印一個理想的物件前，我們可以先了解材料在各條件下能完整列印出物件的極限在哪；因此**Phrozen**提供以下設計建議，幫助您列印物件時大幅提升成功率，並印製出更符合您心目中的物件。

目錄

Sec 1 : TDS	1
Sec 2 : 列印	2
列印參數	2
清洗	5
二固	5
Sec 3: 設計規格	6



Section 1

TDS

基礎特性	規範	代表值
外觀顏色	-	灰色
黏度	BROOKFIELD LV型黏度計	130-180 cps
密度(液態樹脂)	ASTM D4052-18a	1.11 g/cm ³
拉伸特性	規範	代表值 (UV 二固化)
拉伸模量	ASTM D638	2490.6 MPa
斷裂拉伸強度	ASTM D638	35.8 MPa
斷裂伸長率	ASTM D638	17.7 %
彎曲模量	ASTM D790	1900 MPa
彎曲強度	ASTM D790	80 MPa
衝擊性能	規範	代表值 (UV 二固化)
懸樑缺口衝擊強度	ASTM D256	66.4 J/m
熱性能	規範	代表值 (UV 二固化)
HDT at 0.45 MPa	ASTM D648	57 °C
硬度	規範	代表值 (UV 二固化)
Shore D	ASTM D2240	75-80D

* 所有的性能測試都是以Phrozen Sonic Mighty 8K 或 Sonic Mini 8K列印,並使用 Phrozen Cure & Wash 做清洗及二固。
 * 固化時間拉長可提升機械性能,但也將增加不規則形變的機率。

Specimens are printed unless stated otherwise. The information in this TDS, including product recommendations, is based on our current knowledge and experience. Descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights, etc. provided may change without notice and do not establish the product's contractual quality. Request the relevant MSDS from your supplier or contact Phrozen Tech Co., Ltd at sales@phrozen3d.com

Section 2

列印

列印參數

測試機台	Sonic mini / Sonic mini 4K
層厚	50 μ m
一般層曝光時間	3 $\pm$ 0.5 s
底層曝光時間	12.5 $\pm$ 2.5 s
滅燈延遲	14 s
抬升距離	6 mm
抬升速度	60 mm/min

測試機台	Sonic Mini 8K
層厚	50 μ m
一般層曝光時間	4.5 $\pm$ 0.5 s
底層曝光時間	12.5 $\pm$ 2.5 s
靜止時間	5 s
抬升距離	6 mm
抬升速度	60 mm/min

測試機台	Sonic Mini 8K S
層厚	50 μ m
一般層曝光時間	3 $\pm$ 0.5 s
底層曝光時間	8.5 $\pm$ 1.5 s
靜止時間	5 s
抬升距離	6 mm
抬升速度	60 mm/min

測試機台	Sonic Mighty 4K
層厚	50 μ m
一般層曝光時間	5 $\pm$ 0.5 s
底層曝光時間	12.5 $\pm$ 2.5 s
滅燈延遲	14 s
抬升距離	8 mm
抬升速度	60 mm/min

測試機台	Sonic Mighty 8K
層厚	50 μ m
一般層曝光時間	5 $\pm$ 0.5 s
底層曝光時間	12.5 $\pm$ 2.5 s
靜止時間	5 s
抬升距離	8 mm
抬升速度	60 mm/min

測試機台	Sonic Mighty 12K(升級套件)
層厚	50 μ m
一般層曝光時間	5 $\pm$ 0.5 s
底層曝光時間	12.5 $\pm$ 2.5 s
靜止時間	5 s
抬升距離	8 mm
抬升速度	60 mm/min

測試機台	Sonic Mighty Revo
層厚	50 μ m
一般層曝光時間	5 $\pm$ 0.5 s
底層曝光時間	30 $\pm$ 5 s
靜止時間	3 s
抬升距離	8 mm
抬升速度	60 mm/min

測試機台	Sonic Mega 8K*
層厚	50 μ m
一般層曝光時間	5.5 $\pm$ 0.5 s
底層曝光時間	12.5 $\pm$ 2.5 s
靜止時間	5 s
抬升距離	8 mm
抬升速度	45 mm/min

測試機台	Sonic Mega 8K S*
層厚	50 μ m
一般層曝光時間	3 $\pm$ 0.5 s
底層曝光時間	12.5 $\pm$ 2.5 s
靜止時間	5 s
抬升距離	8 mm
抬升速度	60 mm/min

測試機台	Sonic Mega 8K V2*
層厚	30 μm
一般層曝光時間	3 ± 0.5 s
底層曝光時間	22.5 ± 2.5 s
靜止時間	5 s
抬升距離	8 mm
抬升速度	60 mm/min

* Mega 8K / Mega 8K S / Mega 8K V2 因拉拔力較大, 須提高固化秒數以增加列印成功率

* 列印時務必蓋上遮光罩,以維持樹脂最佳列印狀態

* 增加靜止時間可以減緩樹脂積料,已達到更好的解析度。

清洗、靜置

1. 建議使用Phrozen 後處理設備:「Phrozen Cure & Wash」
2. 使用 Phrozen Cure 水流機, 添加95%酒精, 清洗45-60秒。請勿在酒精或其他溶劑 (例IPA) 浸泡超過60秒, 有可能傷害物件表面
3. 空心薄件請務必洗淨內部
4. 清洗後靜置30分鐘即可二固

*薄件貼底印製時請小心鏟下, 有可能讓模型變形

二固

1. 建議使用Phrozen 二固化設備:「Phrozen Cure & Wash」、
「Phrozen Cure」、「Phrozen Mega Cure」等
2. 二固化時間: 120分鐘。

Section 3

設計規格

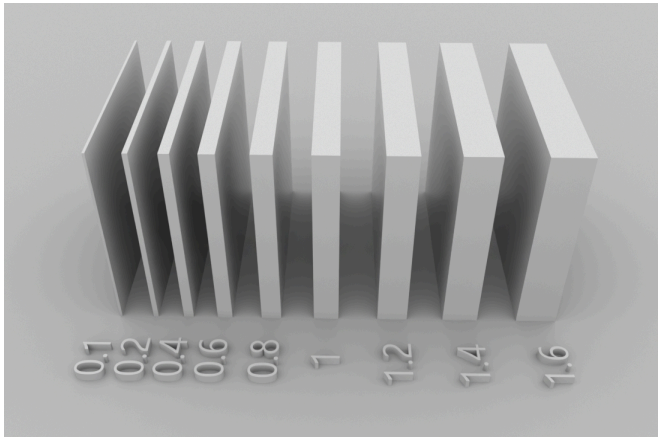
※註: 所有指標均為樹脂之極限值, 會依照使用機台不同有所差距※

Minimum Unsupported Wall Thickness

最小無支撐壁厚

此項指標為在無支撐前提下能獨立印出且無彎曲、斷裂現象之最薄厚度。

建議厚度: ≥ 0.2 mm

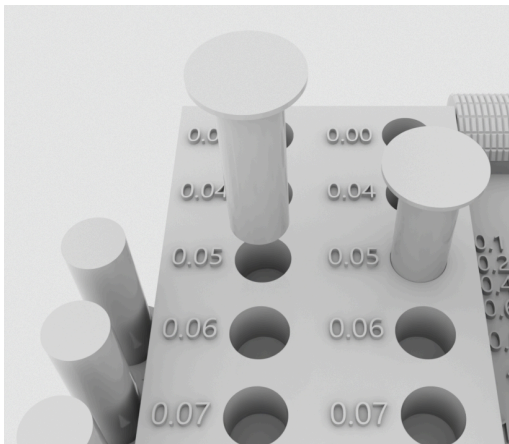


Size Tolerance, X-Y plane

最小尺寸公差

此項指標為平行於XY平面上的孔洞與立柱接合之最小尺寸公差。

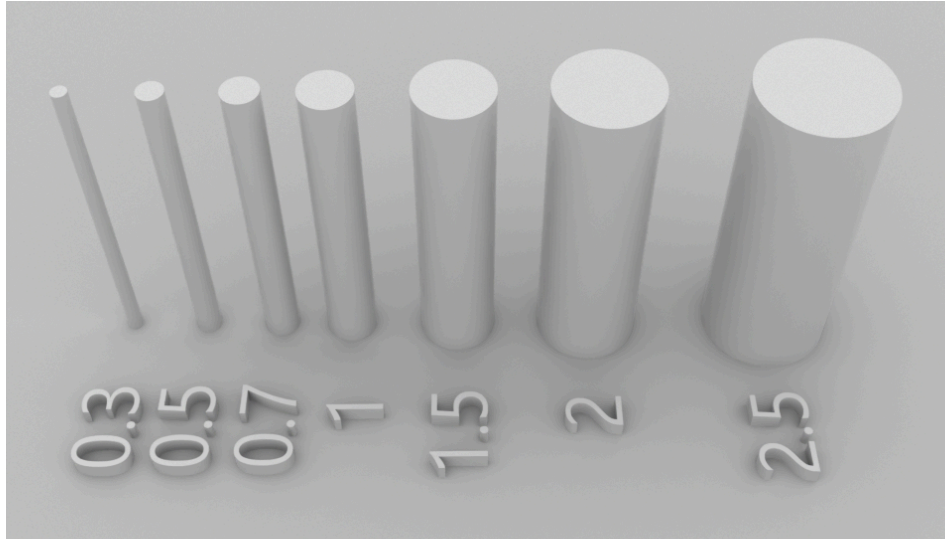
建議公差: ≥ 0.04 mm



Minimum Pin Diameter

最小立柱直徑

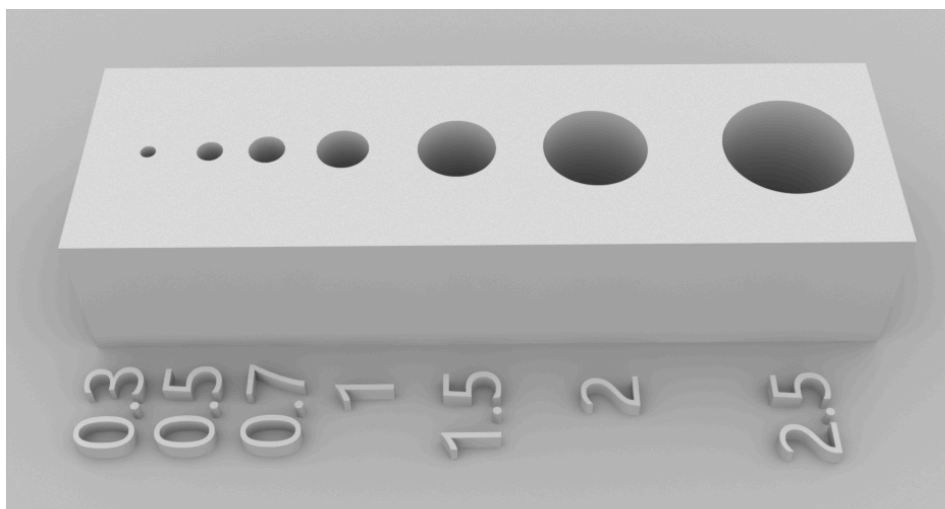
此項指標為細根及支撐能獨立印出且無彎曲、斷裂現象之最小立柱直徑。
建議直徑: ≥ 0.3 mm



Minimum Hole Diameter, X-Y plane

最小孔洞直徑

此項指標為平行於XY平面列印前提下能完整印出之最小孔洞直徑。
建議直徑: ≥ 0.5 mm



Minimum Embossed Detail Width, X-Y plane

最小浮雕細節寬度

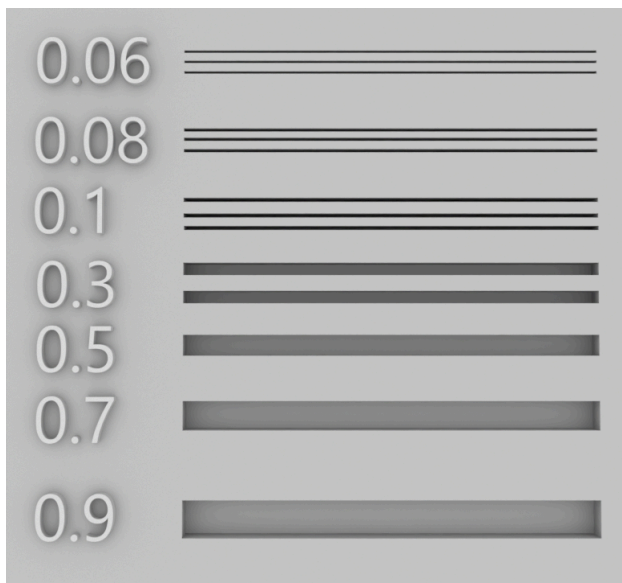
此項指標為可完整列印浮雕細節之最低線條寬度
建議寬度：≥ 0.08 mm



Minimum Engraved Detail Width, X-Y plane

最小雕刻細節寬度

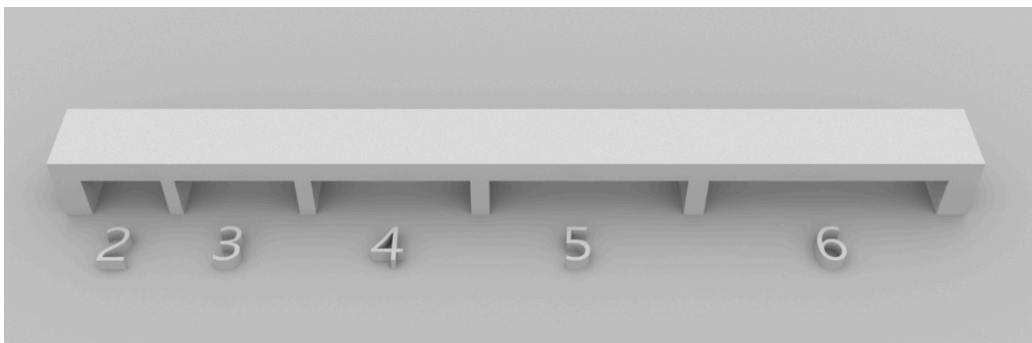
此項指標為可完整列印雕刻細節之最低線條寬度
建議寬度：≥ 0.06 mm



Maximum Horizontal Bridge Span

最大水平跨橋寬度

此項指標為在兩側有支撐壁前提下能印出不變形懸空模型之支撐壁間最大寬度。
建議寬度: ≤ 6 mm



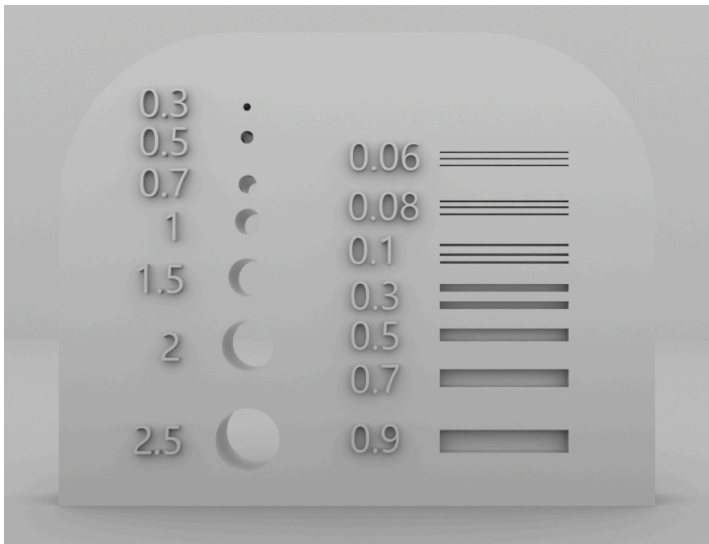
Minimum Hole Diameter and Engraved Detail Width, Z-axis, at 0.05mm layer height

Z軸最小孔洞直徑及最小雕刻凹槽寬度 (0.05mm層高)

此項指標為在層厚為0.05mm時Z軸上可完整印出之最小孔洞直徑及最小雕刻凹槽寬度

建議直徑: ≥ 0.3 mm

建議寬度: ≥ 0.06 mm



Block shrinkage test, at 0.05mm layer height

方塊收縮率測試 (0.05mm層高)

此項指標為平行於XY平面列印2x2x1cm的方塊, 固化後以游標卡尺量測的變形量以計算收縮率。(此測試結果僅供參考, 不同機台不同模型可能會有差異)

計算方式: $[(\text{固化後尺寸} - \text{原始尺寸}) / \text{原始尺寸}] \times 100\%$

X軸建議收縮率: 0.4%

Y軸建議收縮率: 0%

